

**ePaste** ボイド対策 真空リフロー対応 鉛フリーソルダペースト  
**SN100C P810 D4**




**ボイド抑制に特化した高信頼性ソルダペースト**

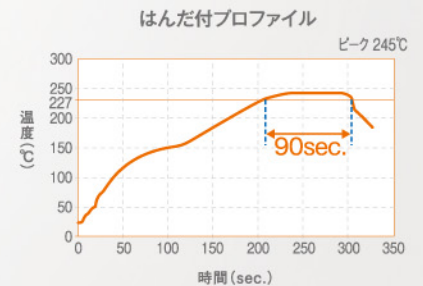
パワー半導体モジュール等の大きな接合面積に対して、ボイドの発生を大幅に低減し、接合信頼性の向上を図ります。真空リフロー炉での使用でさらに低ボイド実装が可能です。

無銀	鉛フリー	印刷用	無洗浄
ボイド抑制	サイドボール抑制	N <sub>2</sub> ・真空リフロー対応	

**ボイド** 従来品に比べ、各雰囲気にてボイドを低減

■ ボイド占有率の比較 (リフロー後のX線写真)



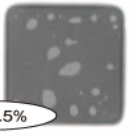



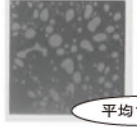
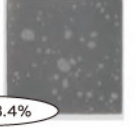

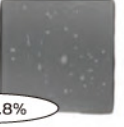
部品の外観 パワートランジスタ TO-262	従来品	SN100C P810 D4		
	大気リフロー	大気リフロー	窒素リフロー	真空リフロー
	ボイド占有率 4.2%	ボイド占有率 3.4%	ボイド占有率 3.0%	ボイド占有率 0.1%



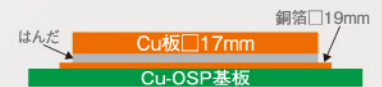
【試験条件】

印刷厚：120μm 本加熱保持時間：90sec. (227℃以上) はんだ付温度：はんだ付プロファイル参照 (真空リフロー) 雰囲気：窒素 減圧時間：40sec. 真空度：6.0kPa

**N<sub>2</sub>・真空雰囲気対応** N<sub>2</sub>雰囲気でもN<sub>2</sub>雰囲気+真空雰囲気でもボイドを大幅に低減

	Cu板	N <sub>2</sub> 雰囲気		N <sub>2</sub> 雰囲気+真空雰囲気	
SN100C					
		平均10.5%		平均0.7%	
SAC305					
		平均18.4%		平均2.8%	

※ □19mm 銅箔 Cu-OSP



【試験条件】

印刷厚：120μm  
本加熱保持時間：90sec. (227℃以上)  
はんだ付温度：はんだ付プロファイル参照 (真空リフロー)  
雰囲気：窒素  
減圧時間：40sec.  
真空度：6.0kPa

※上記データ、写真は特定条件下によるものです。